

# 教育機関提出用 インターン関連情報

## フェイスシート

| 項目     | 記載欄                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 企業名    | ルネサスエレクトロニクス株式会社                                                          |
| 事業所所在地 | 山形県米沢市大字花沢字八木橋東3-3274                                                     |
| WEBサイト | <a href="https://www.renesas.com/jp/ia">https://www.renesas.com/jp/ia</a> |
| 業種     | 製造業                                                                       |
| 事業内容   | 半導体製品の製造                                                                  |
| 担当部署   | 経理統括部 サイトマネジメント(米沢)                                                       |

## インターン内容

| 項目             | 記載欄                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 実施場所           | 米沢工場                                                                                                                                                                                                                                      |
| 実施形態           | リアル                                                                                                                                                                                                                                       |
| 受入期間           | 8/28(月)~9/1(金)に開催するルネサスインターンシップとの合同開催が可能であればこの期間を希望します。<br>上記日程が折り合わなければ8月中旬から9月中旬までの間で調整させて戴きたく。                                                                                                                                         |
| 受入日数           | 5日間                                                                                                                                                                                                                                       |
| 受入人数           | 2名程度を想定                                                                                                                                                                                                                                   |
| 実施時間           | 8:30~17:15                                                                                                                                                                                                                                |
| 体験業種           | 実装技術、製品量産技術                                                                                                                                                                                                                               |
| 主な体験内容         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■生産技術部:半導体Cuワイヤボンディング評価</li> <li>■製品技術部:半導体製造における歩留改善のための現品解析と原因調査の実習</li> </ul>                                                                                                                   |
| ポイント           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■生産技術部:ワイヤボンディング設備条件を変更し出来栄の変化を確認する</li> <li>■製品技術部:不良現品をX線や分解解析し原因究明し、原因工程へフィードバックする</li> </ul>                                                                                                   |
| 受入条件           | 専門知識は不要です。意欲があればどなたでも歓迎します。                                                                                                                                                                                                               |
| 持参物品、昼食有無等の注意点 | 昼食代として参加1日あたり1,000円を支給                                                                                                                                                                                                                    |
| 申込開始日          | 提出後即日                                                                                                                                                                                                                                     |
| 申込締切日          | 2023.7.7(金)                                                                                                                                                                                                                               |
| 実施プログラム        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■生産技<br/>CuワイヤボンディングではAuワイヤに比べて固く、酸化しやすい特徴を考慮したプロセス条件が不可欠である。ボンディング接合信頼性向上を目的とした条件評価が体験できます。</li> <li>■製品技<br/>半導体後工程の量産における品質改善／コスト改善のための歩留まり改善について、原因の究明と対策までの不良品現品の分解・解析やデータ解析、前工程への</li> </ul> |
| 交通・宿泊等に関する補助   | <p>交通費:会社までの往復交通費を支給致します。</p> <p>宿泊施設:現居住地からの参加が困難な場合に限り、宿泊施設を提供致します。</p>                                                                                                                                                                 |